

D-Sub /
D-Sub cover /
Centronics

Multiflex -
DIN 41651

Modular

USB
IEEE 1394

Switches

Powerinlets
Poweroutlets

DIN 41612
DIN 41617
Hard Metric

MiniDIN

Pin header
Female header
Sockets / Jumper

Terminal Blocks

Memory Card
connectors

FFC / FPC

Micro -
Miniature

Im Zuge des zunehmenden Einsatzes von Speicherkarten, als austauschbares Medium in vielen Anwendungen der unterschiedlichsten Endprodukte, hat ASSMANN WSW components das Produktprogramm der Steckverbinder um die passenden Speicherkartensteckverbinder erweitert.

Die Anwendungen sind vielfältig, getrieben von der Computerindustrie, die schon seit vielen Jahren austauschbare Speicherkarten anbietet. Inzwischen finden wir vergleichbare Produkte in den unterschiedlichsten Applikationen, angefangen von mobilen Geräten in der Telekommunikation und Industrie, Phototechnik, Navigationsgeräten im Automobilbereich und nicht zuletzt im Consumer Markt mit z.B.: I-Pots, etc.

Multimedia Card Steckverbindern (MMC) mit 7 Kontakten, im Kontaktbereich durch die feststehenden Abmaße der Speicherkarte genormt, werden von ASSMANN WSW components in den Versionen mit oder ohne Auswerfer angeboten. SD-Kartenverbinder (SD) mit 9 Kontakten, gleichfalls genormt durch die feststehenden Abmaße der Speicherkarte, sind lieferbar mit oder ohne Auswerfer, sowie alternativ als Reverse - Bauform. SIM Card Steckverbinder (SIM) mit 6 Kontakten und optionalen zusätzlichen 2 Schaltkontakten sind ebenfalls Teil der Produktpalette. Bereits seit längerer Zeit verfügbar sind die verschiedenen Varianten der 68 poligen PCMCIA Steckverbinder, die aus einer Stiftleiste und einem Rahmen bestehen. Hier werden unterschiedliche Stand-Off Versionen angeboten, je nach Applikation. Neben den Standardversionen bietet ASSMANN WSW components die Kompetenz Speicherkartensteckverbinder kundenspezifisch modifiziert zu liefern.

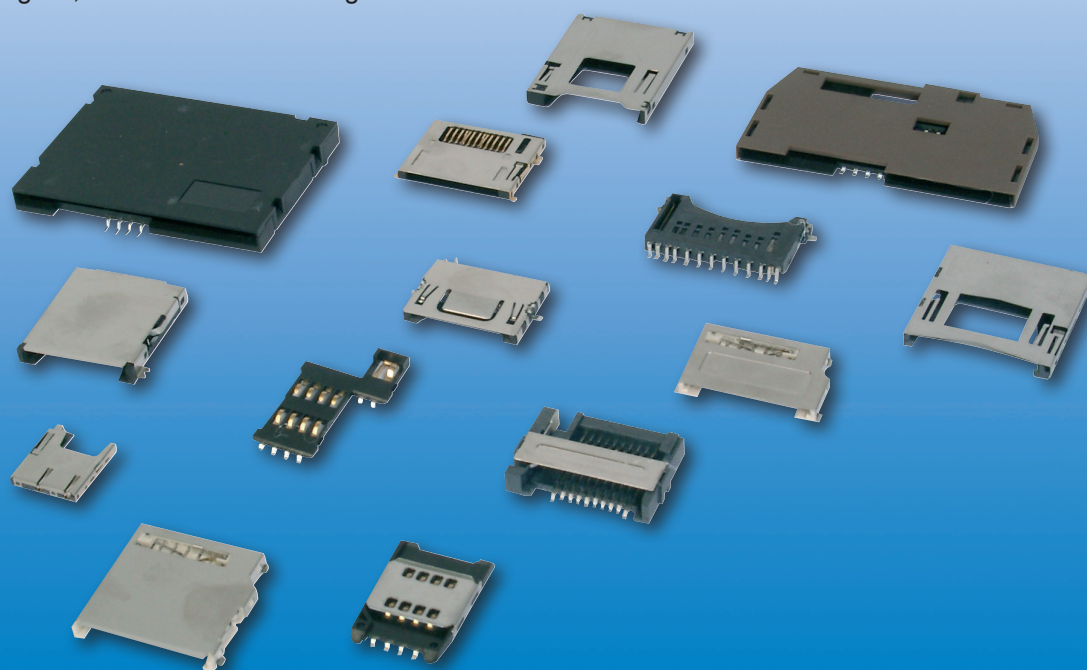
Darüber hinaus können Druckkontaktsteckverbinder nach kundenspezifischer Anforderung konzipiert und gefertigt werden unter Erstellung von produktbezogenen Isolierkörper- und Kontaktstanzwerkzeugen. Diese Steckverbinder finden ihren Einsatz in Board to Board Verbindungen, die über eine einseitige Druckkontak-

In line with the increasing usage of memory cards as an exchangeable medium within different applications for various devices, ASSMANN WSW components extended its connector product range by memory card connectors.

As already mentioned there are various applications, in the past driven by the computer industry, which are using memory cards as well in their end products, eg.: mobile devices in the telecom, digital camera industry, navigation devices within the car and last but not least the consumer industry, etc.

Multimedia Card connectors (MMC) with 7 contacts, an international standard due to the fixed dimensions of the card, are offered by ASSMANN WSW components with ejector or w/o ejector. SD-Card connectors (SD) with 9 contacts, as well an international standard, with and w/o ejector and alternatively available the reverse type. SIM Card connectors (SIM) with 6 contacts and optional 2 additional switching contacts are part of the product range. Already available for some years are different types of the 68 ways PCMCIA connector, consisting out of the 68 ways connector itself and a plastic frame. Different stand-off versions can be offered including ejectors or w/o ejectors. Beside these standard versions ASSMANN WSW components is able to supply customized or modified memory card products.

Furthermore single sided pressure contact connectors can be designed and manufactured according to a customer specific requirement based on customer dedicated insulator- and contact dies. Such single sided pressure contact connectors are mainly used as board to board connection on the base of direct contact to the pads on the board. If additional information is needed, please contact your sales office.

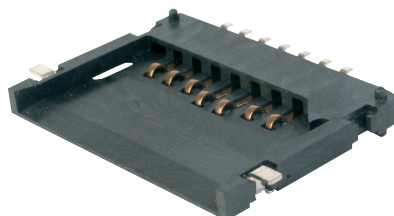


Produktbeschreibung	Seite
Multi-Media-Karten-Sockel, Reverse Ausführung	350
Multi-Media-Karten-Sockel, Standard Ausführung, anreihbar	351
SD-Karten-Sockel, Push-Pull	352
SD-Karten-Sockel, Standard Ausführung	353
SD-Karten-Sockel, Standard Ausführung	354
SD-Karten-Sockel, Reverse Ausführung	355
SIM-Karten-Sockel, Type 1	356
SIM-Karten-Sockel, Type 2, mit Schalter	357
SIM-Karten-Sockel, Type 3	358
SIM-Karten-Sockel, Type 4	359
SIM-Karten-Sockel, Type 5	361
SIM-Karten-Sockel, Type 6	362
PCMCIA-Karten-Sockel, Stecker	364
PCMCIA-Karten-Sockel, Buchse	365

Product description	page
Multi-media-card-socket, reverse style	350
Multi-media-card-socket, standard style, stackable	351
SD-card-socket, push-pull	352
SD-card-socket, standard style	353
SD-card-socket, standard style	354
SD-card-socket, reverse style	355
SIM-card-socket, type 1	356
SIM-card-socket, type 2, with switch	357
SIM-card-socket, type 3	358
SIM-card-socket, type 4	359
SIM-card-socket, type 5	361
SIM-card-socket, type 6	362
PCMCIA-card-socket, male	364
PCMCIA-card-socket, female	365



D-Sub / D-Sub Hauben / Centronics
Multiflex - DIN 41651
Modular
USB IEEE 1394
Schalter
Einbaustecker Einbaubuchsen
DIN 41612 DIN 41617 Hard Metric
MiniDIN
Stiftleisten Buchsenleisten Sockel / Jumper
Klemmleisten
Speicherkarten Steckverbinder
FFC / FPC
Micro- Miniature



Isolierkörpermaterial

LCP, UL94V-0

Kontaktmaterial

Phosphorbronze

Kontaktoberfläche

Ni, Au / Sn

Kontaktwiderstand

100mΩ max

Isolationswiderstand

1000MΩ min

Strombelastbarkeit

1A

Betriebstemperatur

-40°C - +85°C

Verpackung

Stangenverpackung

Insulator material

LCP, UL94V-0

Contact material

Phosphor bronze

Plating

Ni, Au / Sn

Contact resistance

100mΩ max

Insulation resistance

1000MΩ min

Current rating

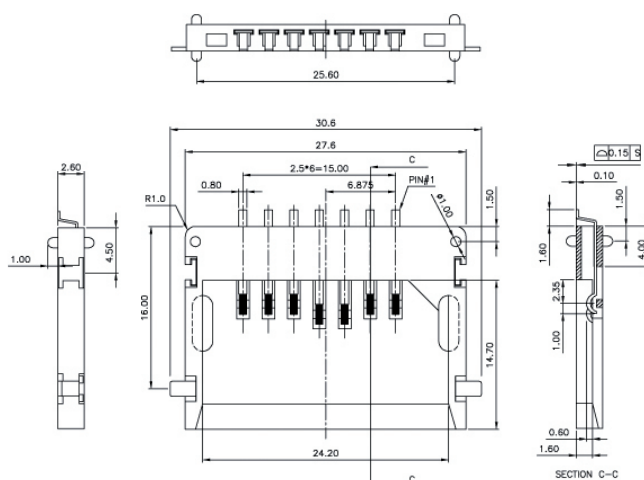
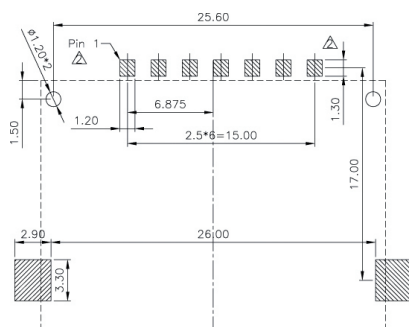
1A

Operating temperature

-40°C - +85°C

Packing

Tube packing



Bestellcode / Ordercode

Polzahl

07 - 07 polig

No. of contacts

07 - 07 contacts

Oberfläche

C - Gold 15μ" (selektiv)*

D - Gold 30μ" (selektiv)

Contact plating

C - 15μ" gold (selective)*

D - 30μ" gold (selective)

R - Reverse Ausführung

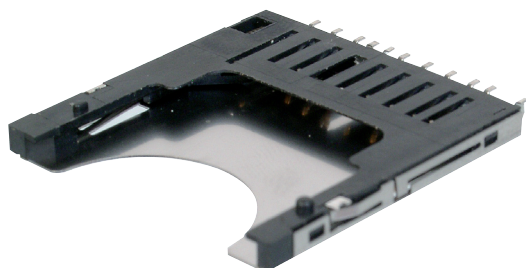
R - Reverse style

A - MMC - 07 - x - R

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

***Standard**
***Standard**

351



Isolierkörpermaterial

LCP, UL94V-0

Kontaktmaterial

Phosphorbronze

Kontaktoberfläche

Ni, Au / Sn

Kontaktwiderstand

40mΩ max

Isolationswiderstand

1000MΩ min

Strombelastbarkeit

0.5A

Betriebstemperatur

-20°C - +85°C

Prüfspannung

250V AC

Verpackung

Blisterverpackung

Insulator material

LCP, UL94V-0

Contact material

Phosphor bronze

Plating

Ni, Au / Sn

Contact resistance

40mΩ max

Insulation resistance

1000MΩ min

Current rating

0.5A

Operating temperature

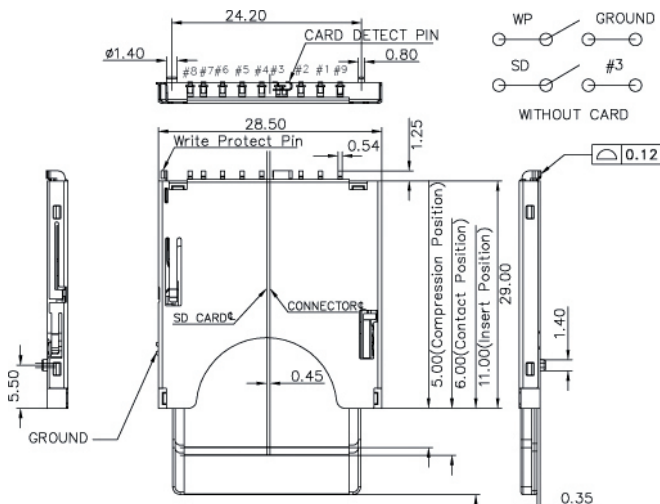
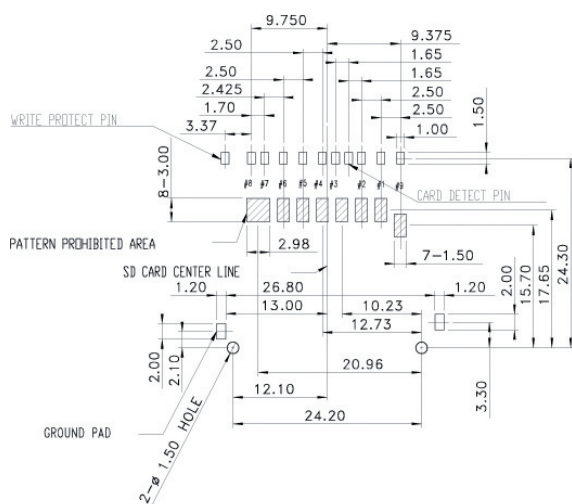
-20°C - +85°C

Test voltage

250V AC

Packing

Tray packing



Bestellcode / Ordercode

Polzahl

09 - 09 polig

No. of contacts

09 - 09 contacts

Kontaktoberfläche

C - Gold 15μ" (selektiv)*
D - Gold 30μ" (selektiv)

Contact plating

C - 15μ" gold (selective)*
D - 30μ" gold (selective)

A - SD - 09 - x - A - 1 - 3

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

***Standard**
***Standard**

SD-Karten-Sockel, Standard Ausführung
SD-card-socket, standard style

Isolierkörpermaterial

LCP, UL94V-0

Kontaktmaterial

Phosphorbronze

Kontaktoberfläche

Ni, Au / Sn

Kontaktwiderstand

100mΩ max

Isolationswiderstand

1000MΩ min

Strombelastbarkeit

1A

Betriebstemperatur

-20°C - +85°C

Prüfspannung

250V AC

Verpackung

Blisterverpackung

Insulator material

LCP, UL94V-0

Contact material

Phosphor bronze

Plating

Ni, Au / Sn

Contact resistance

100mΩ max

Insulation resistance

1000MΩ min

Current rating

1A

Operating temperature

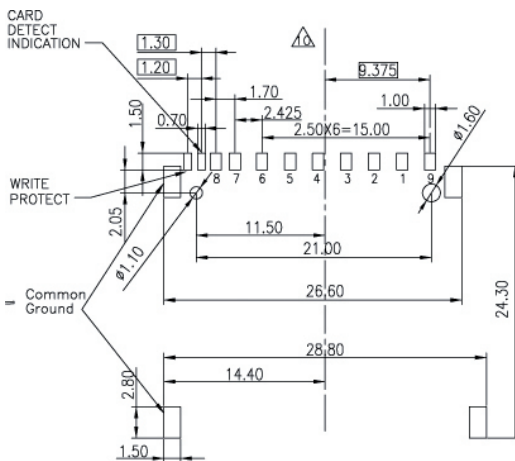
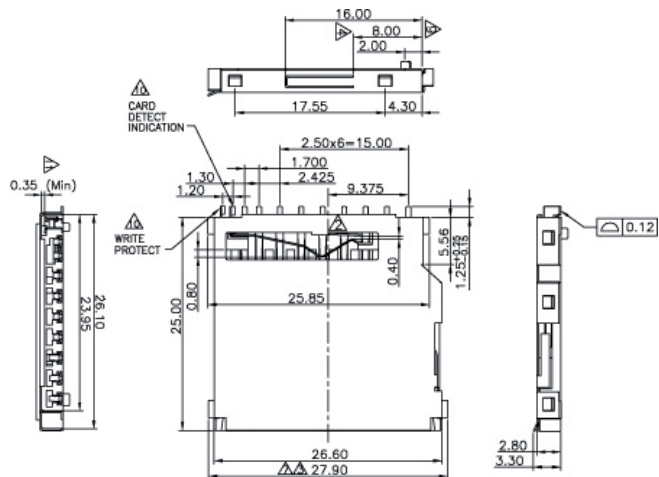
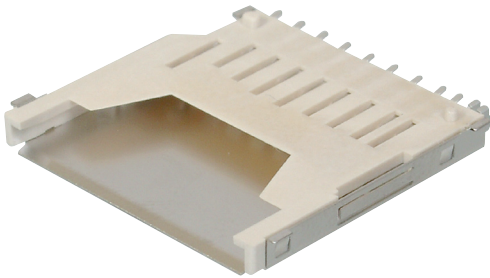
-20°C - +85°C

Test voltage

250V AC

Packing

Tray packing



Bestellcode / Ordercode

Polzahl

09 - 09 polig

No. of contacts

09 - 09 contacts

Kontaktoberfläche

C - Gold 15μ" (selektiv)*
D - Gold 30μ" (selektiv)

Contact plating

C - 15μ" gold (selective)*
D - 30μ" gold (selective)

A - SD - 09 - x - 0 - 7 - 3

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

*Standard
*Standard

D-Sub /
D-Sub Hauben /
Centronics

Multiflex -
DIN 41651

Modular

USB
IEEE 1394

Schalter

Einbaustecker
Einbaubuchsen

DIN 41612
DIN 41617
Hard Metric

MiniDIN

Stiftleisten
Buchsenleisten
Sockel / Jumper

Klemmleisten

Speicherkarten
Steckverbinder

FFC / FPC

Micro-
Miniature

Isolierkörpermaterial

LCP, UL94V-0

Kontaktmaterial

Phosphorbronze

Kontaktfläche

Ni, Au / Sn

Kontaktwiderstand

100mΩ max

Isolationswiderstand

1000MΩ min

Strombelastbarkeit

1A

Betriebstemperatur

-20°C - +85°C

Prüfspannung

250V AC

Verpackung

Blisterverpackung

Insulator material

LCP, UL94V-0

Contact material

Phosphor bronze

Plating

Ni, Au / Sn

Contact resistance

100mΩ max

Insulation resistance

1000MΩ min

Current rating

1A

Operating temperature

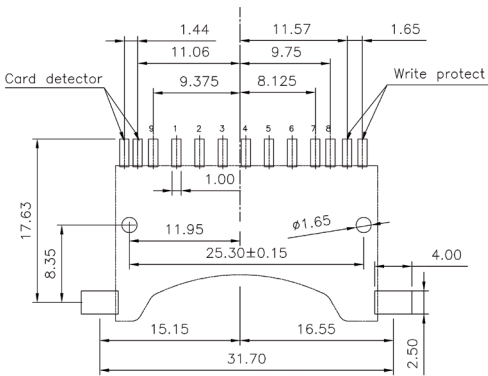
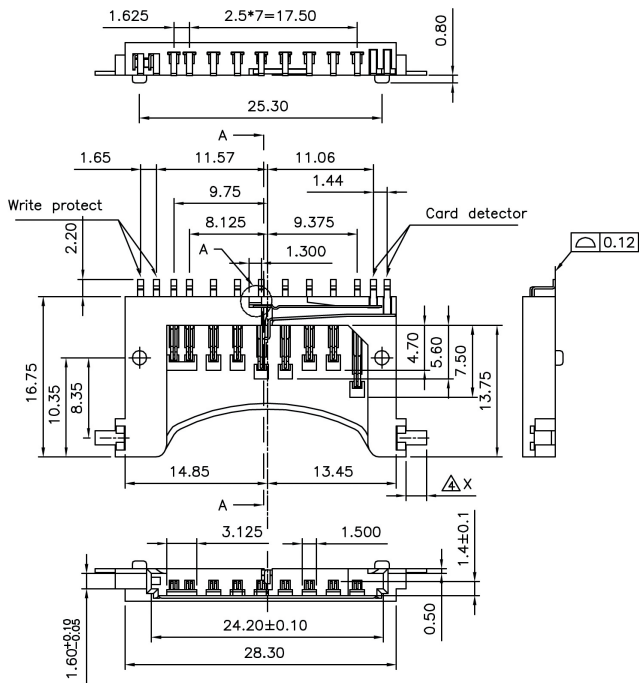
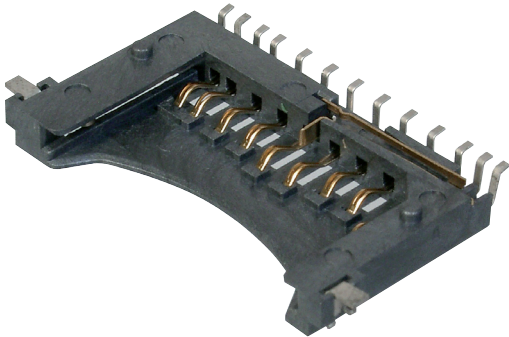
-20°C - +85°C

Test voltage

250V AC

Packing

Tray packing



Bestellcode / Ordercode

Polzahl

09 - 09 polig

No. of contacts

09 - 09 contacts

Anschluss (Dim. für X)

0 - 1.5mm
1 - 0.8mm

Tap option (Dim. For X)

0 - 1.5mm
1 - 0.8mm

R - Reverse Ausführung

R - Reverse style

Oberfläche

C - Gold 15μ" (selektiv)*
D - Gold 30μ" (selektiv)

Contact plating

C - 15μ" gold (selective)*
D - 30μ" gold (selective)

A - SD - 09 - x - R - x - 3

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

*Standard
*Standard

D-Sub /
D-Sub Hauben /
Centronics

Multiflex -
DIN 41651

Modular

USB
IEEE 1394

Schalter

Einbaustecker
Einbaubuchsen

DIN 41612
DIN 41617
Hard Metric

MiniDIN

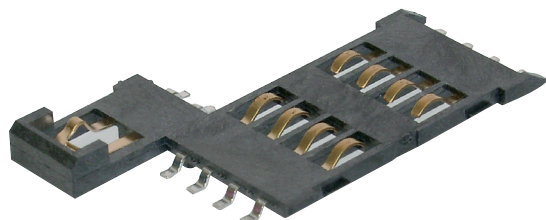
Stiftleisten
Buchsenleisten
Sockel / Jumper

Klemmleisten

Speicherkarten
Steckverbinder

FFC / FPC

Micro-
Miniature



Isolierkörpermaterial

LCP, UL94V-0

Kontaktmaterial

Phosphorbromze

Kontaktoberfläche

A: Ni, Au / Sn

B: Ni, Sn

Kontaktwiderstand

100mΩ max

Isolationswiderstand

1000MΩ min

Strombelastbarkeit

0.5A

Betriebstemperatur

-40°C - +85°C

Prüfspannung

500V AC

Verpackung

Blisterverpackung

Insulator material

LCP, UL94V-0

Contact material

Phosphor bronze

Plating

A: Ni, Au / Sn

B: Ni, Sn

Contact resistance

100mΩ max

Insulation resistance

1000MΩ min

Current rating

0.5A

Operating temperature

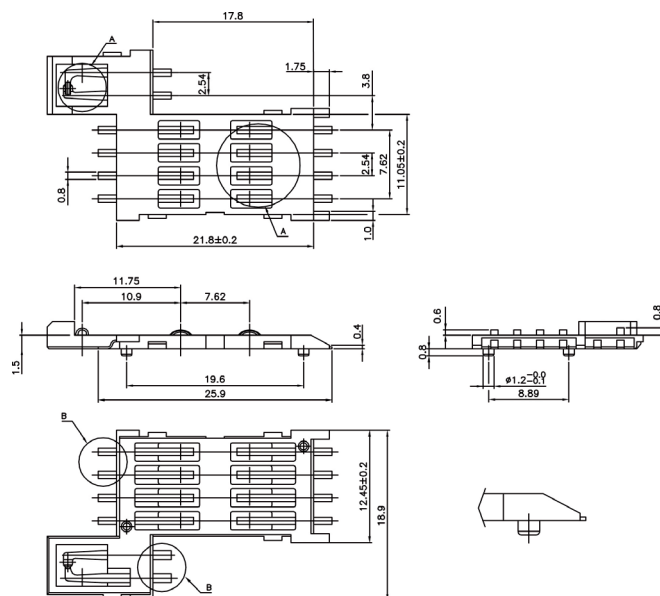
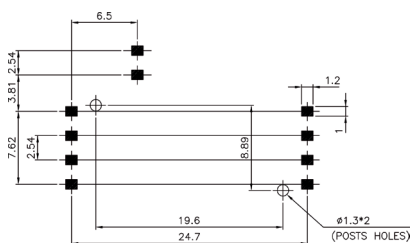
-40°C - +85°C

Test voltage

500V AC

Packing

Tray packing



Bestellcode / Ordercode

Polzahl

08 - 08 polig

No. of contacts

08 - 08 contacts

Kontaktoberfläche

C - Gold 15μ" (selektiv)*

D - Gold 30μ" (selektiv)

K - Gold 50μ" (selektiv)

Contact plating

C - Gold 15μ" (selective)*

D - Gold 30μ" (selective)

K - Gold 50μ" (selective)

A - SIM - 08 - 01 - x - 003

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

***Standard**
***Standard**

SIM-Karten-Sockel, Type 2, mit Schalter
SIM-card-socket, type 2, with switch

Isolierkörpermaterial

LCP, UL94V-0

Kontaktmaterial

Phosphorbromz

Kontaktfläche

A: Ni, Au / Sn

B: Ni, Sn

Kontaktwiderstand

100mΩ max

Isolationswiderstand

1000MΩ min

Strombelastbarkeit

0.5A

Betriebstemperatur

-40°C - +105°C

Prüfspannung

500V AC

Verpackung

Blisterverpackung

Insulator material

LCP, UL94V-0

Contact material

Phosphor bronze

Plating

A: Ni, Au / Sn

B: Ni, Sn

Contact resistance

100mΩ max

Insulation resistance

1000MΩ min

Current rating

0.5A

Operating temperature

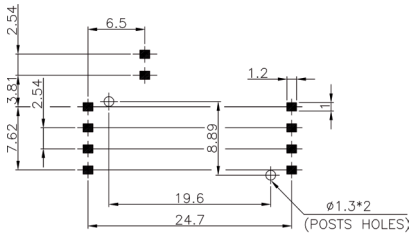
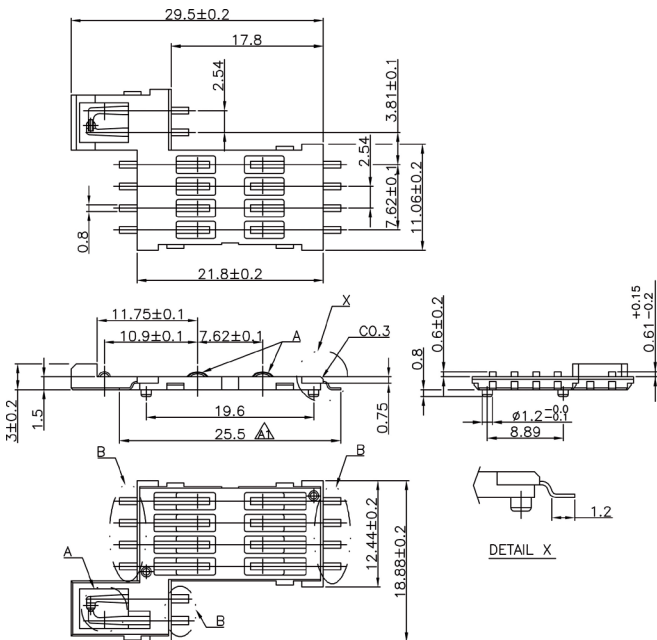
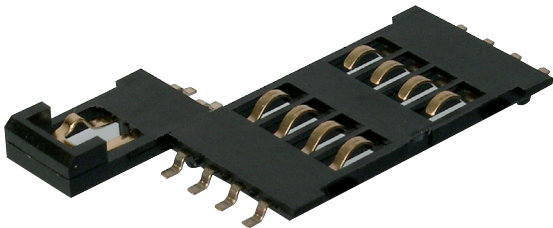
-40°C - +105°C

Test voltage

500V AC

Packing

Tray packing



Bestellcode / Ordercode

Polzahl

08 - 08 polig

No. of contacts

08 - 08 contacts

Kontaktfläche

C - Gold 15μ" (selektiv)*
D - Gold 30μ" (selektiv)
K - Gold 50μ" (selektiv)

Contact plating

C - Gold 15μ" (selective)*
D - Gold 30μ" (selective)
K - Gold 50μ" (selective)

A - SIM - 08 - 02 - x - 003

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

*Standard
*Standard

D-Sub /
D-Sub Hauben /
Centronics

Multiflex -
DIN 41651

Modular

USB
IEEE 1394

Schalter

Einbaustecker
Einbaubuchsen

DIN 41612
DIN 41617
Hard Metric

MiniDIN

Stiftleisten
Buchsenleisten
Sockel / Jumper

Klemmleisten

Speicherkarten
Steckverbinder

FFC / FPC

Micro-
Miniature



Isolierkörpermaterial

LCP, UL94V-0

Kontaktmaterial

Phosphorbronze

Kontaktoberfläche

Ni, Au / Sn

Kontaktwiderstand

100mΩ max

Isolationswiderstand

1000MΩ min

Strombelastbarkeit

0.5A

Betriebstemperatur

-40°C - +85°C

Prüfspannung

500V AC

Verpackung

Blisterverpackung

Insulator material

LCP, UL94V-0

Contact material

Phosphor bronze

Plating

Ni, Au / Sn

Contact resistance

100mΩ max

Insulation resistance

1000MΩ min

Current rating

0.5A

Operating temperature

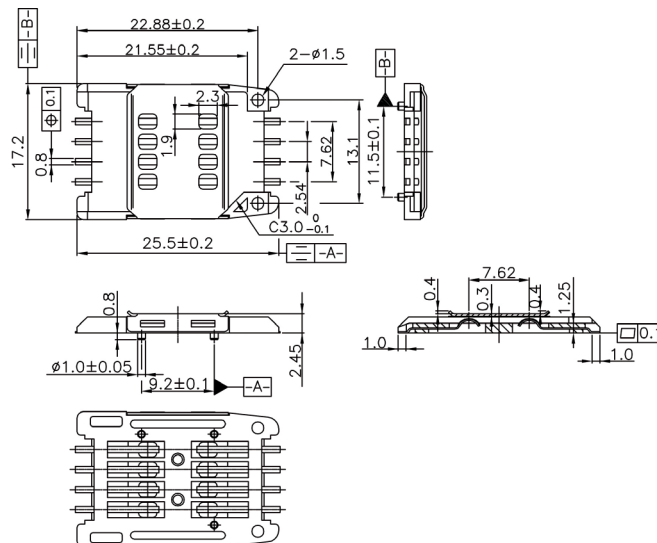
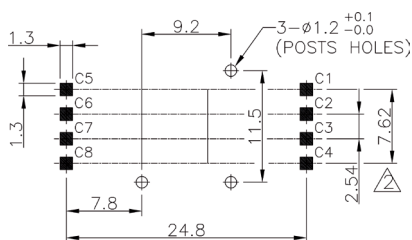
-40°C - +85°C

Test voltage

500V AC

Packing

Tray packing



Bestellcode / Ordercode

Polzahl

08 - 08 polig

No. of contacts

08 - 08 contacts

Kontaktoberfläche

C - Gold 15μ" (selektiv)*

D - Gold 30μ" (selektiv)

K - Gold 50μ" (selektiv)

Contact plating

C - Gold 15μ" (selective)*

D - Gold 30μ" (selective)

K - Gold 50μ" (selective)

A - SIM - 08 - 03 - x - 003

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

***Standard**
***Standard**

Isolierkörpermaterial

LCP, UL94V-0

Kontaktmaterial

Phosphorbronze

Kontaktoberfläche

Ni, Au

Kontaktwiderstand

50mΩ max

Isolationswiderstand

1000MΩ min

Strombelastbarkeit

1A

Betriebstemperatur

-25°C - +60°C

Prüfspannung

1000V AC

Verpackung

Rollenverpackung

Insulator material

LCP, UL94V-0

Contact material

Phosphor bronze

Plating

Ni, Au

Contact resistance

50mΩ max

Insulation resistance

1000MΩ min

Current rating

1A

Operating temperature

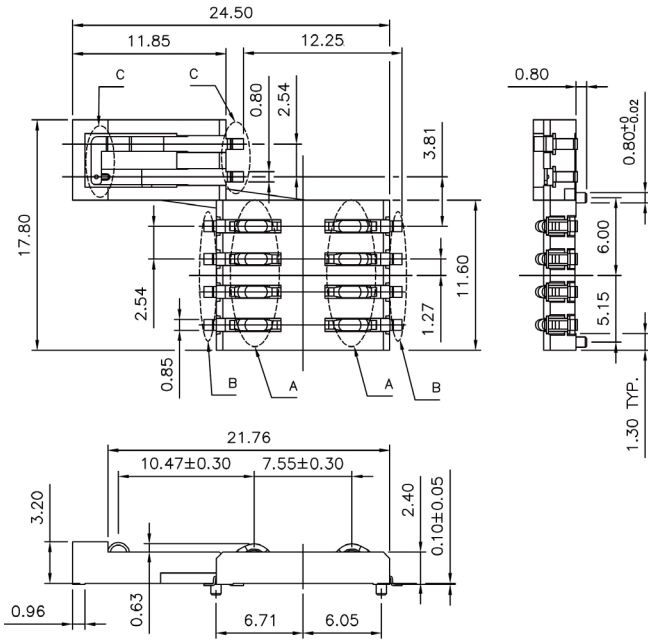
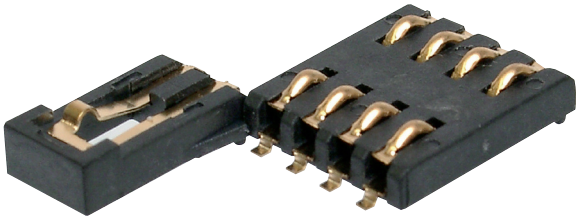
-25°C - +60°C

Test voltage

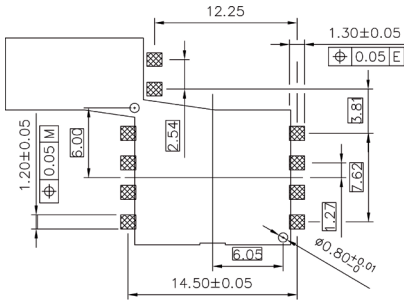
1000V AC

Packing

Reel packing



Platings		
A	B	C
30μ" GOLD	4μ" GOLD	GOLD FLASH



Bestellcode / Ordercode

Polzahl

08 - 08 polig

No. of contacts

08 - 08 contacts

A - SIM - 08 - 04 - Z - 003

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

*Standard
*Standard

D-Sub /
D-Sub Hauben /
Centronics

Multiflex -
DIN 41651

Modular

USB
IEEE 1394

Schalter

Einbaustecker
Einbaubuchsen

DIN 41612
DIN 41617
Hard Metric

MiniDIN

Stiftleisten
Buchsenleisten
Sockel / Jumper

Klemmleisten

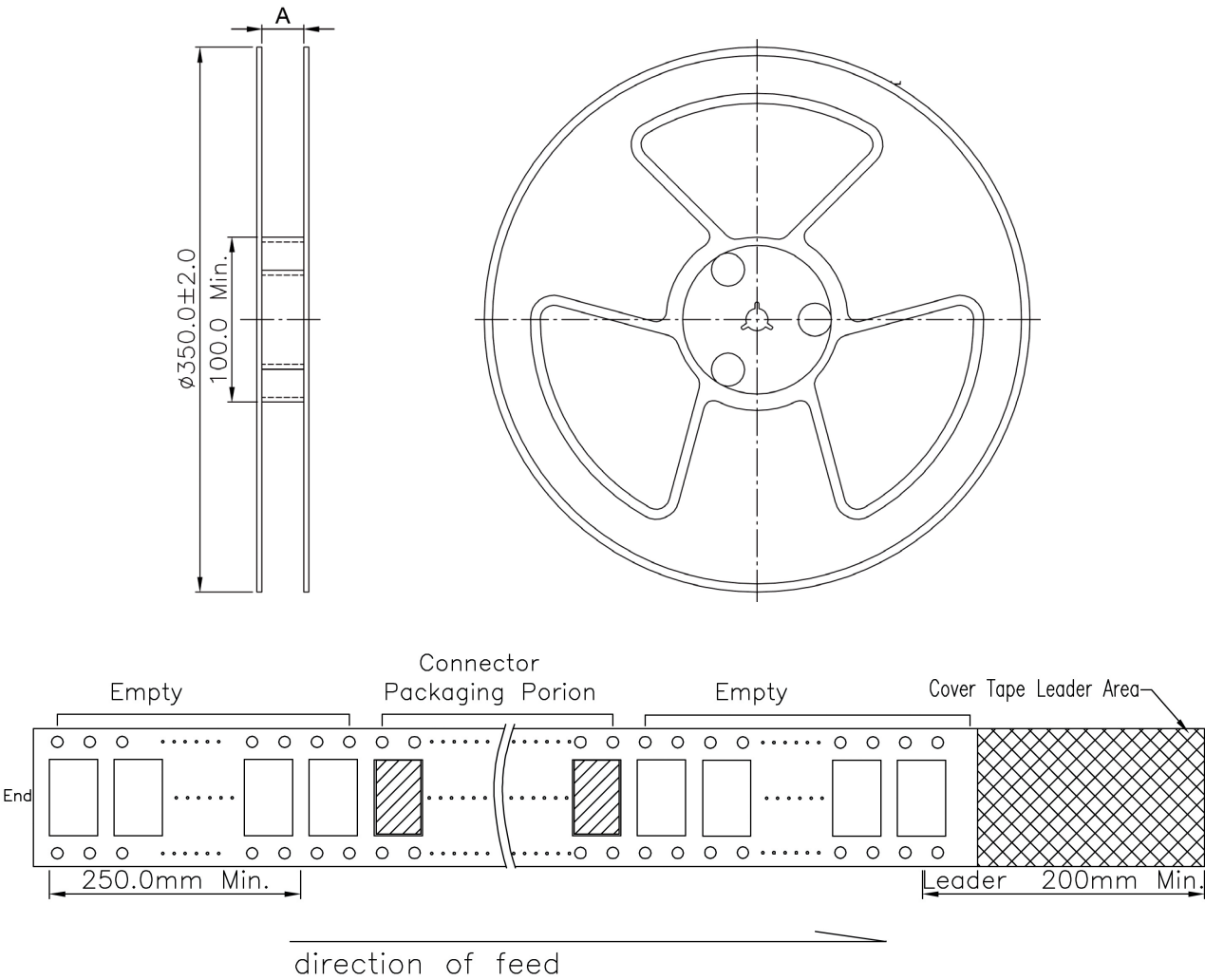
Speicherkarten
Steckverbinder

FFC / FPC

Micro-
Miniature

Verpackung entspricht
EIA-481-C.

Packing according to
EIA-481-C.



No. of contacts	A	Qty per Reel
8	44	500

SIM-Karten-Sockel, Type 5
SIM-card-socket, type 5

Isolierkörpermaterial
LCP, UL94V-0

Kontaktmaterial
Phosphorbromze

Kontaktoberfläche
Ni, Au / Sn

Kontaktwiderstand
100mΩ max

Isolationswiderstand
1000MΩ min

Strombelastbarkeit
1A

Betriebstemperatur
-40°C - +90°C

Prüfspannung
500V AC

Verpackung
Blisterverpackung

Insulator material
LCP, UL94V-0

Contact material
Phosphor bronze

Plating
Ni, Au / Sn

Contact resistance
100mΩ max

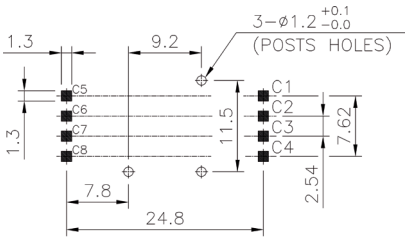
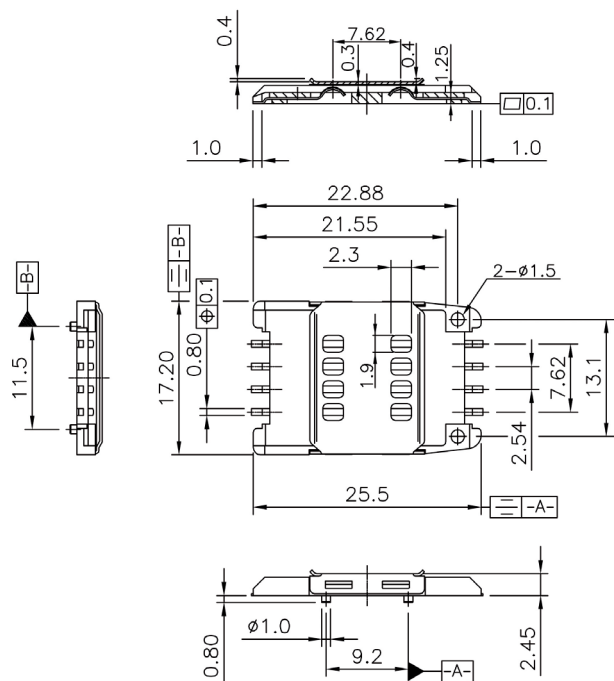
Insulation resistance
1000MΩ min

Current rating
1A

Operating temperature
-40°C - +90°C

Test voltage
500V AC

Packing
Tray packing



Bestellcode / Ordercode

Polzahl

08 - 08 polig

No. of contacts

08 - 08 contacts

Kontaktoberfläche

C - Gold 15μ" (selektiv)*
D - Gold 30μ" (selektiv)
K - Gold 50μ" (selektiv)

Contact plating

C - Gold 15μ" (selective)*
D - Gold 30μ" (selective)
K - Gold 50μ" (selective)

A - SIM - 08 - 05 - x - 003

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

*Standard
*Standard

D-Sub /
D-Sub Hauben /
Centronics

Multiflex -
DIN 41651

Modular

USB
IEEE 1394

Schalter

Einbaustecker
Einbaubuchsen

DIN 41612
DIN 41617
Hard Metric

MiniDIN

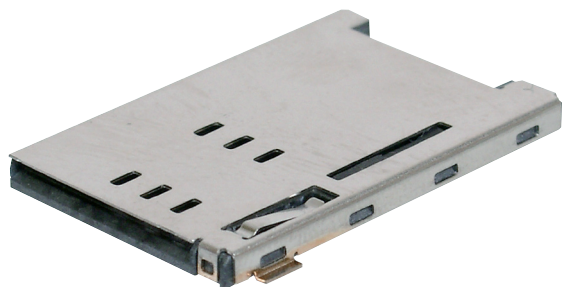
Stiftleisten
Buchsenleisten
Sockel / Jumper

Klemmleisten

Speicherkarten
Steckverbinder

FFC / FPC

Micro-
Miniature



Isolierkörpermaterial
LCP, UL94V-0

Kontaktmaterial
Phosphorbromze

Kontaktoberfläche
Ni, Au / Sn

Kontaktwiderstand
30mΩ max

Isolationswiderstand
500MΩ min

Strombelastbarkeit
0.5A

Betriebstemperatur
-55°C - +85°C

Prüfspannung
250V AC

Verpackung
Rollenverpackung

Insulator material
LCP, UL94V-0

Contact material
Phosphor bronze

Plating
Ni, Au / Sn

Contact resistance
30mΩ max

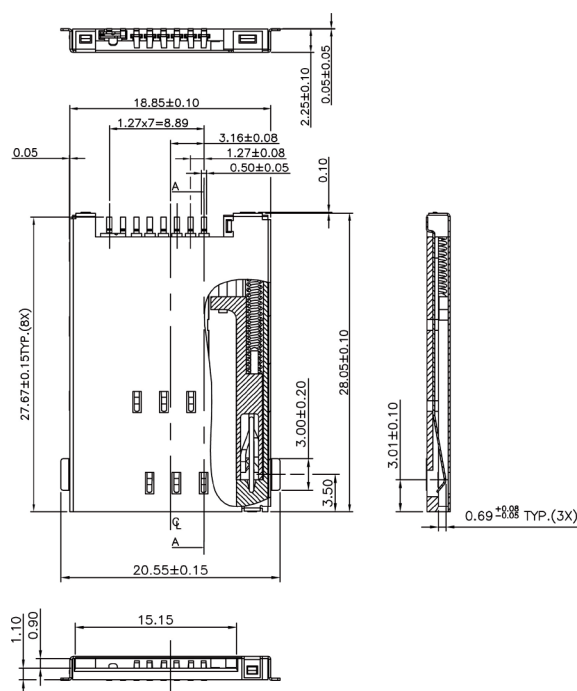
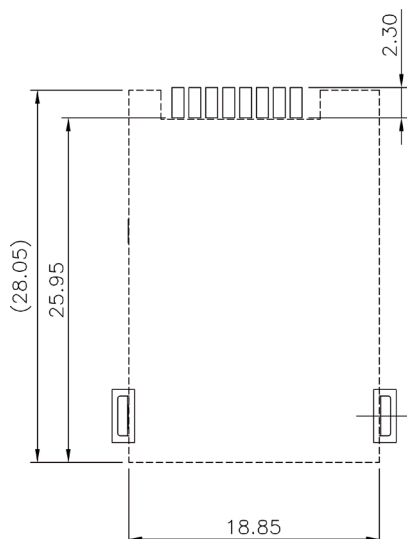
Insulation resistance
500MΩ min

Current rating
0.5A

Operating temperature
-55°C - +85°C

Test voltage
250V AC

Packing
Reel packing



Bestellcode / Ordercode

Polzahl

08 - 08 polig

No. of contacts

08 - 08 contacts

Kontaktoberfläche

C - Gold 15μ" (selektiv)*
D - Gold 30μ" (selektiv)

Contact plating

C - Gold 15μ" (selective)*
D - Gold 30μ" (selective)

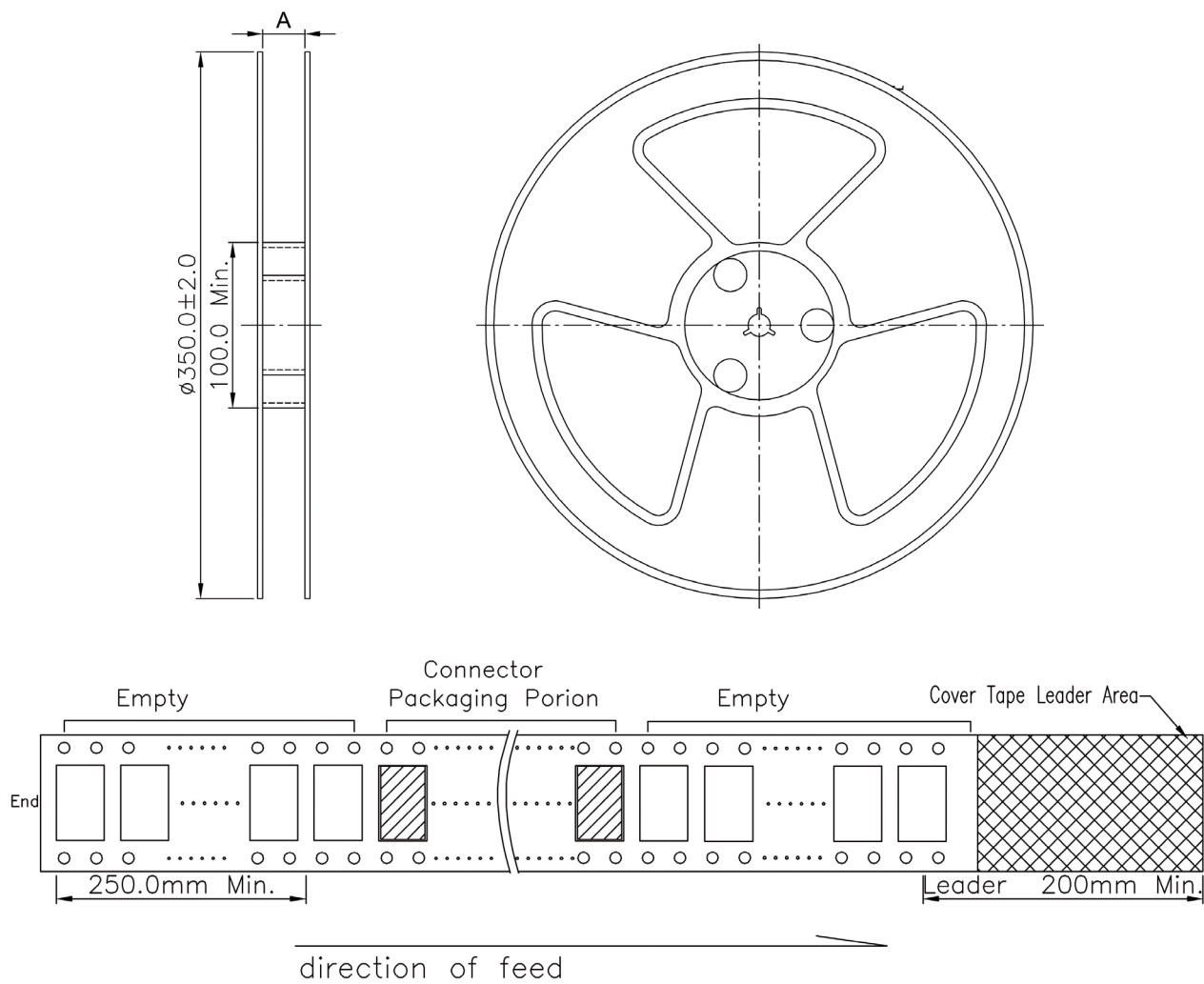
A - SIM - 08 - 06 - x - 003

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

***Standard**
***Standard**

Verpackung entspricht
EIA-481-C.

Packing according to
EIA-481-C.



No. of contacts	A	Qty per Reel
8	44	700

D-Sub /
D-Sub Hauben /
Centronics

Multiflex -
DIN 41651

Modular

USB
IEEE 1394

Schalter

Einbaustecker
Einbaubuchsen

DIN 41612
DIN 41617
Hard Metric

MiniDIN

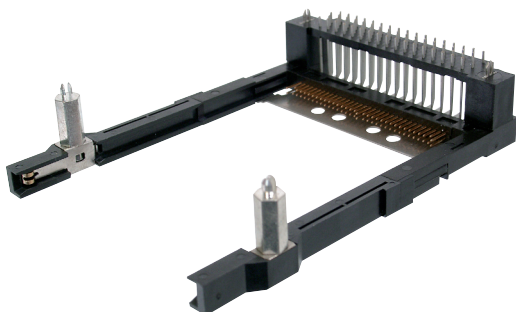
Stiftleisten
Buchsenleisten
Sockel / Jumper

Klemmleisten

Speicherkarten
Steckverbinder

FFC / FPC

Micro-
Miniature



Isolierkörpermaterial
PA9T, UL94V-0

Kontaktmaterial
Phosphorbromze

Kontaktoberfläche
Ni, Au / Sn

Kontaktwiderstand
40mΩ max

Isolationswiderstand
1000MΩ min

Strombelastbarkeit
1A

Betriebstemperatur
-40°C - +85°C

Prüfspannung
1000V AC

Verpackung
Blisterverpackung

Insulator material
PA9T, UL94V-0

Contact material
Phosphor bronze

Plating
Ni, Au / Sn

Contact resistance
40mΩ max

Insulation resistance
1000MΩ min

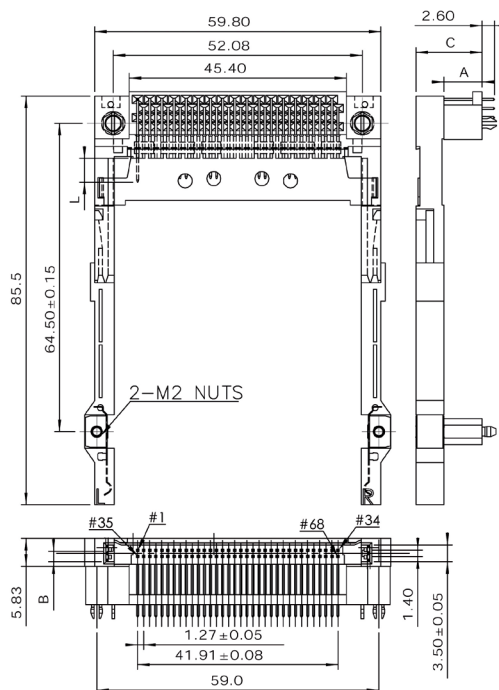
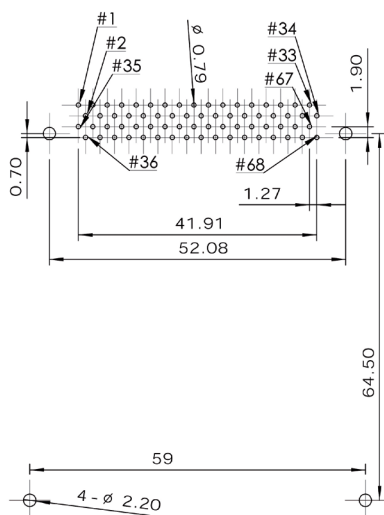
Current rating
1A

Operating temperature
-40°C - +85°C

Test voltage
1000V AC

Packing
Tray packing

Description	Pin Number	L±0.10
Power	1 / 17 / 34 / 35 / 51 / 68	5.00
General	All other pins	4.25
Detect	36 / 67	3.50



Bestellcode / Ordercode

Zubehör

- 0 - ohne Gewindemutter M2
- 1 - mit Gewindemutter M2

Betriebsspannung & Dim B

- 1 - 5.0V - 1.1mm
- 2 - 3.3V - 2.2mm

Abstand Dim A & Dim C

- 1 - 4.0mm / 9.83mm
- 5 - 7.0mm / 12.83mm
- 8 - 10.0mm / 15.83mm

Kontaktoberfläche

- C - Gold 15μ" (selektiv)*
- D - Gold 30μ" (selektiv)

Parts option

- 0 - without Nut M2
- 1 - with Nut M2

Voltage & Dim B

- 1 - 5.0V - 1.1mm
- 2 - 3.3V - 2.2mm

Stand-off Dim A & Dim C

- 1 - 4.0mm / 9.83mm
- 5 - 7.0mm / 12.83mm
- 8 - 10.0mm / 15.83mm

Contact plating

- C - Gold 15μ" (selective)*
- D - Gold 30μ" (selective)

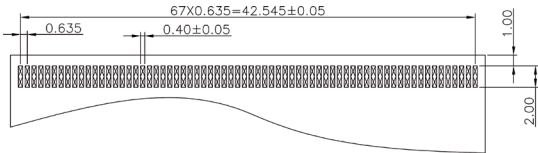
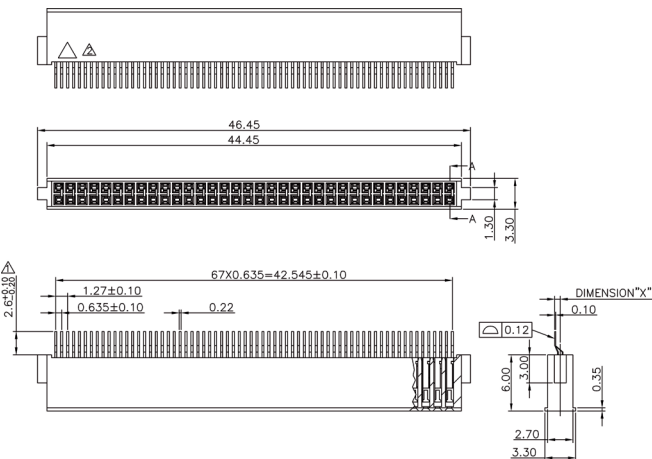
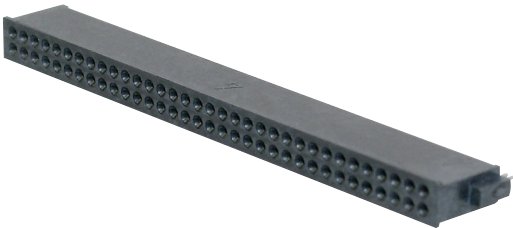
A - PCMCIA - 68 - x - x - x - x

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

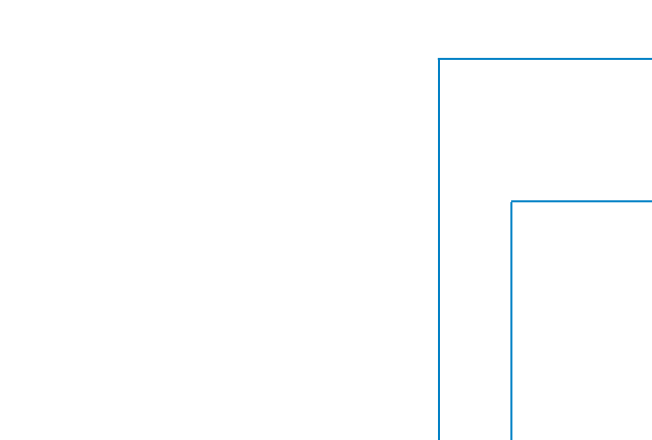
***Standard**
***Standard**

Isolierkörpermaterial
PA9T, UL94V-0
Kontaktmaterial
Phosphorbronze
Kontaktoberfläche
Ni, Au / Sn
Kontaktwiderstand
40mΩ max
Isolationswiderstand
1000MΩ min
Strombelastbarkeit
1A
Betriebstemperatur
-10°C - +70°C
Prüfspannung
1000V AC
Verpackung
Stangenverpackung

Insulator material
PA9T, UL94V-0
Contact material
Phosphor bronze
Plating
Ni, Au / Sn
Contact resistance
40mΩ max
Insulation resistance
1000MΩ min
Current rating
1A
Operating temperature
-10°C - +70°C
Test voltage
1000V AC
Packing
Tube packing



Bestellcode / Ordercode



Versatz Dim X	Offset Dim X
1 - 0.3mm	1 - 0.3mm
2 - 0.5mm	2 - 0.5mm
3 - 0.6mm	3 - 0.6mm
4 - 0.8mm	4 - 0.8mm
5 - 0.95mm	5 - 0.95mm

Kontaktoberfläche	Contact plating
C - Gold 15µ" (selektiv)*	C - Gold 15µ" (selective)*
D - Gold 30µ" (selektiv)	D - Gold 30µ" (selective)

A - PCMCIA - 68 - F - x - x - 003

Bitte „x“ durch die geeignete Option ersetzen
Please replace „x“ with appropriate option

*Standard
*Standard

D-Sub / D-Sub Hauben / Centronics
Multiflex - DIN 41651
Modular
USB IEEE 1394
Schalter
Einbaustecker Einbaubuchsen
DIN 41612 DIN 41617 Hard Metric
MiniDIN
Stiftleisten Buchsenleisten Sockel / Jumper
Klemmleisten
Speicherkarten Steckverbinder
FFC / FPC
Micro- Miniature